

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

闻泰科技股份有限公司
2025 年 9 月投资者关系活动记录表

编号：2025-09-001

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☐ 电话会议
参与单位及人员	博时基金、财通资管、Charm Partners、北京神农投资、晨曦投资、淡水泉（北京）投资管理有限公司、东北证券、东方财富证券、敦和资产、复星联合健康保险、广发基金、国海证券、国联民生证券、国泰海通资管、国泰产险、国泰基金、国信证券、国元证券、海富通基金、国源信达资本、研几私募基金、华泰保兴、华泰证券、华鑫证券、华源证券、汇丰晋信基金、合肥建投资本、昆明产业开发投资、锡创投、云南锦苑股权投资、建信保险资管、建信基金、交银施罗德基金、杰鼎基金、九方智投、九祥资产、理成资产、弥远投资、摩根大通证券、摩根基金、南银理财、宁泉资产、宁涌富私募基金、平安证券、泊通资产、浦银国际证券、乾瞻投资、钦沐资产、泉果基金、融通基金、睿郡资产、上海保银私募基金、上海国有资本投资、上海聆泽私募基金、上海证券、申万宏源证券、太平洋证券、五矿证券、西部证券、新华资产、兴业证券、兴证全球基金、银华基金、沅沅投资、源毅资产、远信投资、长城证券、长盛基金、长信基金、中庚基金、中欧基金、中信建投证券、中信证券、中银证券、中信资管、东方证券、中金公司、天治基金等
时间	2025 年 9 月 25 日 13:00
地点	上海临港
公司接待人员	董事长 杨沐，CFO、代董事会秘书 张彦茹，IR 徐国靖
投资者关系活动主要内容介绍	公司组织召开投资者线下调研，杨沐董事长系统分享了公司战略转型半导体业务的中长期规划，对公司产品线中长期增长机会做了具体阐述，并发布了公司未来五年增长计划。公司半导体业务集成电路解决方案（ICS）事业部、宽禁带、IGBT 及模组（WIM）事业部分别介绍了公司模拟芯片和高压功率器件在 AI 电源及汽车中的应用进展。投资者现场参观了公司控股股东代建的临港 12 吋车规晶圆产线，公司管理层现场回答了投资者提问，主要情况总结提炼如下： 1、请介绍一下公司模拟芯片产品的收入情况及产品进展？ 公司 2025 年上半年逻辑 IC 与模拟 IC 的收入占比 17.63%，其中逻辑 IC 出货量全球第二，2025 年上半年通过国产替代显著提升了份额，公司希望未来能够做到全球第一市占率。模拟 IC 则是目前公司重点的投资领域，主要集中在隔离 IC、I2C、信号处理和电源 IC，针对车载和 AI 的应用做了大量布局，也是公司未来几年收入增速最快的领域之一。 在汽车模拟芯片领域的新产品，主要应用于域控制器、车灯、智能座舱和三电领域：新推出的 NCA953x 系列用于 I2C 和 SM 总线提供 16 比特通用输入/输出（GPIO）扩展。其中 NCA9535 是业内第一个通过车规认证的同类产品。另外 NXU 产品系列用于 UART，SPI，JTAG 及通用 I/O 接口的固定方向电平转换更加可靠。与 NXU953x 系列配对的 NXU954x 多路复用器解决了 I2C 接口各类限制问题。同时配对的 NCA6416 提供 I2C GPIO 电压转换。三类产品为最新汽车电器架构从 DCU 到 ZCU+CCU 过渡的架构接口方向提供整

	体解决方案。在汽车智能座舱领域，基于 USB PD3.2 标准最高可支持 240 瓦的双口快充车规控制器 IC 在头部汽车客户实现量产。包含的具有强差异化的智能双口功率动态分配和基于温度与电池电压的功率管理，业界领先，达到系统功耗最优化及可靠保护系统与电池。在汽车车灯领域，12、16、24 通道 LED 驱动器实现量产交付，且全系列均满足 ISO26262 ASIL-B 功能安全等级，与我们已经量产的 LDO，DCDC，MOS 组成了车灯整体解决方案。另外推出业内领先的超低待机静态电流通用低压差 (LDO) 稳压器，可为 MCU、CAN/LIN 收发器等需持续待机运行的元器件提供高效供电解决方案，适用于汽车信息娱乐系统、辅助驾驶系统、远程信息处理及照明系统、车身控制模块、区域控制单元、动力系统等汽车及工业应用。所有用于汽车的新 IC 均符合 AEC-Q100 标准并在头部厂商批量使用。 在 AI 电源模拟芯片领域，公司主要布局了 Hot-swap、E-fuse、POL、DC-DC 和 SPS 等核心产品，目前通过云厂商、XPU 厂商进行送样，在 2025 年 PCIM Asia 上海展会中，展示了公司在 AI 服务器电源中模拟 IC、MOS 与保护器件的完整解决方案，满足 AI 服务器的可扩展性、高可靠性等需求。 公司新推出 NEX82016 数模混合 LLC 原边控制器和 NEX8191X LLC 副边同步整流控制器两大系列产品，支持从一百瓦到一千瓦左右的电源设计，非常适用于工业电源、医疗电源、服务器电源、TV 电源和消费类电源等应用场合。 2、能否分享公司宽禁带、IGBT 及模组（WIM）等高压业务的进展，如何展望公司 WIM 产品线未来的发展趋势？ 公司半导体业务长期发展战略是“从低压向高压，从功率向模拟”不断拓展产品，通过高 ASP、高性能的新产品快速提升收入，GaN、SiC 和 IGBT 等高压产品是未来增长的重要方向，2024 年起我们对公司高压产品团队进行了整合，也补充了更多的相关专业技术人才，因此无论是产品研发量产进度还是客户推广进度都显著加快，2025 年公司 GaN、SiC 的新产品不断发布，也在汽车、工业和消费客户中都获得了 design in、design win 的订单。 目前公司半导体业务已经完成了 40-700V 新型低压和高压 E-mode GaN FET 产品组合、1200V 车规级 SiC MOS 的正式发布，SiC Trench（沟槽型）MOS 已经完成研发，性能和转化效率提升明显，量产后会实现 SiC MOS 的弯道超车，将成为未来公司 SiC MOS 的拳头产品。目前公司 SiC MOS 在 Tier1 客户 OBC 中开始量产交付，并送样北美、欧洲和国内新能源汽车客户，反馈良好，也获得了头部 AI 电源客户的 design in 订单。 GaN 芯片已经在北美云厂商的新一代手机、头部通信设备厂商的通讯基站设施中实现量产出货，并且在和头部车企战略合作推进 GaN 上车，同时也在向头部服务器电源客户送样。 2024 年投资 2 亿美金建设的汉堡的 GaN、SiC 产线进展顺利，预计 2025 年底通线，工艺能力和自主化进一步提升。 IGBT 产品方面，现有产品我们已经顺利量产到国内的空调压缩机项目，并且导入了电机和家电客户的空调控制板和马达项目，预计 2025 年第四季度量产交付。预计 2025 年底将在临港晶圆厂实现 12 吋 IGBT 新一代产品通线量产，将会比现有产品更有竞争力。
--	--

我们预计高压产品从 2026 年起高压产品会进入量产放量期，公司半导体业务目前在中低压功率器件销售中全球排名第三、中国排名第一，未来公司希望高压功率器件的销售也能位于全球前列。

3、如何展望公司半导体业务第三季度及下半年增长趋势，各个下游市场如何展望？

从第三季度订单情况看，公司半导体业务的收入环比持续增长。目前订单能见度下，各个下游的景气度趋势较好：

汽车方面中国区的增长势头延续，更重要的是欧洲汽车客户的库存健康，从第二季度逐步进入补库周期，欧洲新能源汽车的渗透率提升显著，考虑到欧洲区汽车收入占公司汽车业务整体收入接近 4 成，这一趋势将有力带动公司汽车领域收入的环比增长。

工业方面，上半年公司半导体业务工业和 AI 电源相关的收入同比增长超过 16%，全球性工业复苏的趋势比较明显，国内的设备更新政策、全球各个地区的再工业化以及数据中心建设需求旺盛，都带动了工业订单的上升，第三季度从订单看，工业和电源相关的订单环比仍在延续增长。

消费类方面，上半年消费领域（家电等）收入同比增长逾 50%，计算设备受 AIPC、AI 服务器出货增长带动，收入同比增长超 25%，移动及可穿戴业务符合终端出货趋势，同比增长约 10%，下半年将持续受益于消费电子新产品旺季、消费补贴政策延续等因素。

4、公司如何看待 AI 数据中心电源架构变化带来的机会，请分享公司在 AIDC 电源相关的布局情况及竞争优势？

数据中心和服务器电源是公司半导体业务重要的下游应用，从行业整体看会相关的市场规模年化增速超过 30%，公司的功率器件、逻辑与模拟 IC 产品都大量应用其中。从产品和客户进展两个维度看：

从客户维度看，目前公司的产品主要是通过几类客户供应到 AI 数据中心和服务器中：第一类是海外和国内算力的头部服务器 ODM 厂商，公司也有专门的团队针对 XPU 厂商、云厂商送样产品进入参考设计中，提高公司产品价值量；第二类是供应 UPS、PSU 等产品的国内外电源 Tier1 厂商，公司与他们保持长期稳定的合作关系。

从产品维度看，随着 AI 服务器单机功耗提升、可扩展性、可靠性和成本效率等需求发展，公司车规级品质、PPB 级质量管控能力提供了“一站式产品组合”帮助客户应对挑战，包括：通过 ESD for CAN、USB4.0、保护高达 600W 的 TVS 二极管等产品提供电源保险功能；通过电源“ASSETS”系列在 12V 和 48V 电源架构中具有增强的安全工作区（SOA），并且具备顶级散热封装、用于热插拔的 eMode GaN 和双向 eGaN 器件；提供双向和固定方向的电压转换、GPIO 扩展器、模拟多路复用器和开关等保障信号接口功能；此外还构建了一些电源管理 IC，包括 LDO、DC/DC、负载开关、eFuse、理想二极管、USB PD 电源传输控制器、热插拔控制器等；提供电网、UPS、PDU、PSU 等适用的宽禁带第三代半导体器件和 IGBT 及模组，应对未来数据中心耗电量成倍增长需求。

这些客户和产品组合上的长期积累，帮助公司构建了“一站式分立器件和模拟 IC 采购平台”，从而在 AI 电源应用供应链生态中占据良好的供应格局。

	5、公司半导体业务中国区业务的进展情况？占比如何？后续有哪些值得期待的大客户或项目？如何看待公司在国内市场竞争的成本优势？ 2025 年上半年公司半导体业务中国区收入占比超过 48%，同比增长超过 20%，汽车、工业和消费领域的收入增速都较好，中国区汽车客户收入同比增长接近 40%。长期看，中国区在汽车、AI 和消费电子市场的引领作用较为显著，也是公司半导体业务新产品发力的重点区域之一，近期在中国区客户上的一些新产品进展包括： MOSFET 产品方面，公司基于临港晶圆厂 12 寸工艺升级的新一代 MOS 产品已经成功进入国内头部新能源汽车客户供应链，预计从 10 月份开始量产出货。新工艺平台下 MOS 产品的成本和产品性能得到极大优化，将公司 MOSFET 产品由 40V 逐步向中高压 MOS 产品系列拓展，更好地支撑新能源汽车、AI 服务器、人形机器人等产品向 48V 平台架构演进。 高压功率器件方面，SiC MOS、IGBT 都已经获得国内汽车客户、空调家电客户的订单，下半年开始交付出货，在今年上海车展上，吉利与雷诺合资的浩思动力发布的产品搭载了公司的高压 GaN 器件，目前也在联合推动 GaN 上车的量产工作。在 PCIM Asia 展会上，公司也展出了 3KW GaN 马达驱动、12-48V 无刷电机驱动、充电桩 AC/DC 模块等高压应用，加快在工业电源、汽车驱动、机器人电机等方面的客户推广。 模拟芯片方面，车灯 LED 驱动 IC、LDO 稳压 IC 等模拟芯片新品都已经开始量产交付，基于 USB PD3.2 标准最高可支持 240 瓦的双口快充车规控制器 IC 成功实现量产。 对于中国区的竞争问题，公司作为功率和模拟芯片国产化的重要力量，正在积极推动国产化芯片在汽车、工业和消费中的应用，2025 年上半年 Logic IC 和 MOS 等产品在中国区的国产替代订单增长显著。公司的优势在于丰富的料号储备、车规级高规格产品质量和领先的工艺技术平台，目前依托国内临港晶圆厂的产能和工艺，自动化率和效率都大幅提升，同时公司也在积极引入国产供应链，优化成本，提高竞争力。从销售和售后维护上，公司凭借全面、高可靠、可扩展性的料号组合打造“功率、模拟芯片一站式采购”服务，与客户更深度协同。随着公司更多产品实现了本地化研发、生产，中国区的 FAE、失效分析等职能越发健全，客户响应速度明显提升，更好地为中国区客户的创新产品提供支撑和服务。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 9 月 29 日